

【公報種別】特許法第17条の2の規定による補正の掲載

【部門区分】第7部門第2区分

【発行日】令和1年5月9日(2019.5.9)

【公開番号】特開2017-204508(P2017-204508A)

【公開日】平成29年11月16日(2017.11.16)

【年通号数】公開・登録公報2017-044

【出願番号】特願2016-94153(P2016-94153)

【国際特許分類】

H 01 L 21/677 (2006.01)

H 01 L 21/027 (2006.01)

G 11 B 5/84 (2006.01)

【F I】

H 01 L 21/68 A

H 01 L 21/30 5 0 2 D

G 11 B 5/84 Z

【手続補正書】

【提出日】平成31年3月18日(2019.3.18)

【手続補正1】

【補正対象書類名】特許請求の範囲

【補正対象項目名】全文

【補正方法】変更

【補正の内容】

【特許請求の範囲】

【請求項1】

それが基板を処理する複数の処理部を含む基板処理装置であって、

搬送路を有し、前記基板処理装置の外から前記搬送路の一端に搬入された基板を前記複数の処理部のうちのいずれかに搬送する搬送部と、

前記一端から前記複数の処理部のうちのいずれかに搬入される基板のプリアライメント状態を調整する調整部と、を含み、

前記調整部は、前記搬送路において、前記複数の処理部のうち前記一端から最も遠い処理部と前記一端から最も近い処理部との間に配置され、

前記搬送路は、前記調整部を介して互いに分離された第1搬送路および第2搬送路を含み、前記搬送部は、前記第1搬送路に沿って基板を搬送する第1搬送部と、前記第2搬送路に沿って基板を搬送する第2搬送部とを含む

ことを特徴とする基板処理装置。

【請求項2】

前記調整部は、前記基板の温度調整を行う温度調整部を含むことを特徴とする請求項1に記載の基板処理装置。

【請求項3】

前記温度調整部での前記温度調整が済んだ基板を前記調整部から前記複数の処理部のうちのいずれかに搬送するように、前記搬送部を制御する制御部を含むことを特徴とする請求項2に記載の基板処理装置。

【請求項4】

前記調整部は、複数の基板を収納可能な収納部を含むことを特徴とする請求項1乃至3のいずれか1項に記載の基板処理装置。

【請求項5】

前記収納部に収納された基板のうち前記調整部での前記調整が済んだ基板を前記収納部から前記複数の処理部のうちのいずれかに搬送するように、前記搬送部を制御する制御部

を含むことを特徴とする請求項 4 に記載の基板処理装置。

【請求項 6】

前記調整部を複数含み、前記調整部の数は、前記複数の処理部における処理部の数より少ないことを特徴とする請求項 1 に記載の基板処理装置。

【請求項 7】

前記複数の調整部と前記複数の処理部との間の対応関係が予め設定されていることを特徴とする請求項 6 に記載の基板処理装置。

【請求項 8】

前記複数の調整部のうちいずれかの状態に基づいて前記対応関係を変更する制御部を含むことを特徴とする請求項 7 に記載の基板処理装置。

【請求項 9】

それぞれが基板を処理する複数の処理部を含む基板処理装置であって、
搬送路を有し、前記基板処理装置の外から前記搬送路の一端に搬入された基板を前記複数の処理部のうちのいずれかに搬送する搬送部と、

前記一端から前記複数の処理部のうちのいずれかに搬入される基板のプリアライメント状態を調整する調整部と、を含み、

前記調整部は、前記搬送路において、前記複数の処理部のうち前記一端から最も遠い処理部と前記一端から最も近い処理部との間に配置され、

前記調整部は、複数の基板を収納可能な収納部を含む
ことを特徴とする基板処理装置。

【請求項 10】

それぞれが基板を処理する複数の処理部を含む基板処理装置であって、
搬送路を有し、前記基板処理装置の外から前記搬送路の一端に搬入された基板を前記複数の処理部のうちのいずれかに搬送する搬送部と、

前記一端から前記複数の処理部のうちのいずれかに搬入される基板のプリアライメント状態を調整する調整部と、を含み、

前記調整部は、前記搬送路において、前記複数の処理部のうち前記一端から最も遠い処理部と前記一端から最も近い処理部との間に配置され、

前記調整部を複数含み、前記調整部の数は、前記複数の処理部における処理部の数より少ない

ことを特徴とする基板処理装置。

【請求項 11】

それぞれが基板を処理する第 1 及び第 2 の処理部を含む基板処理装置であって、
前記第 1 及び第 2 の処理部のうちのいずれかに搬入される基板のプリアライメント状態を調整する調整部と、

前記基板が前記基板処理装置内に搬入された位置から前記調整部までの第 1 搬送路に沿って前記基板を搬送し、前記調整部から前記基板が前記基板処理装置内から外部に搬出される位置までの第 2 搬送路に沿って前記基板を搬送する搬送部と、を含み、

前記第 1 の処理部は前記第 1 搬送路に沿った位置に配置されており、前記第 2 の処理部は前記第 2 搬送路に沿った位置に配置されていることを特徴とする基板処理装置。

【請求項 12】

前記複数の処理部のそれぞれは、パターン形成を基板に行うことを特徴とする請求項 1 乃至 10 のうちいずれか 1 項に記載の基板処理装置。

【請求項 13】

前記第 1 及び第 2 の処理部のそれぞれは、パターン形成を基板に行うことを特徴とする請求項 11 に記載の基板処理装置。

【請求項 14】

請求項 12 又は 13 に記載の基板処理装置を用いてパターン形成を基板に行う工程と、
前記工程で前記パターン形成を行われた前記基板を処理する工程と、
を含むことを特徴とする物品製造方法。

【手続補正2】

【補正対象書類名】明細書

【補正対象項目名】0007

【補正方法】変更

【補正の内容】

【0007】

本発明の一側面によれば、それぞれが基板を処理する複数の処理部を含む基板処理装置であって、搬送路を有し、前記基板処理装置の外から前記搬送路の一端に搬入された基板を前記複数の処理部のうちのいずれかに搬送する搬送部と、前記一端から前記複数の処理部のうちのいずれかに搬入される基板のプリアライメント状態を調整する調整部と、を含み、前記調整部は、前記搬送路において、前記複数の処理部のうち前記一端から最も遠い処理部と前記一端から最も近い処理部との間に配置され、前記搬送路は、前記調整部を介して互いに分離された第1搬送路および第2搬送路を含み、前記搬送部は、前記第1搬送路に沿って基板を搬送する第1搬送部と、前記第2搬送路に沿って基板を搬送する第2搬送部とを含むことを特徴とする基板処理装置が提供される。